



# 硅整流桥堆

## R6S05-H



### 产品概述

R6S05-H 是硅整流桥堆，该产品采用平面工艺，高温下漏电电流极小，可靠性较高。

### 产品特点

- 超低反向漏电电流
- 封装厚度薄
- ESD 击穿电压高
- 无铅封装
- 耐焊接温度高

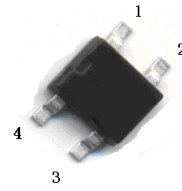
### 应用

- LED 整流电路
- 节能灯
- 中小功率电源

### 特征参数

| 符号    | 额定值 | 单位 |
|-------|-----|----|
| $V_R$ | 600 | V  |
| $I_F$ | 0.5 | A  |

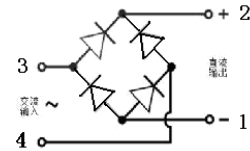
### 封装 SOP4



### 存储条件和焊接温度

| 存放有效期 | 存放条件                      | 极限耐焊接热 |
|-------|---------------------------|--------|
| 1 年   | 环境温度-10℃~40℃<br>相对湿度 <85% | 265℃   |

### 内部结构图



### 极限值 (Per Diode)

除非另有规定,  $T_a=25^{\circ}\text{C}$

| 参数名称       | 符号              | 额定值     | 单位   |
|------------|-----------------|---------|------|
| 重复峰值反向电压   | $V_{RRM}$       | 600     | V    |
| 直流阻断电压     | $V_{DC}$        | 600     | V    |
| 平均正向整流电流   | $I_{F(AV)}$     | 0.5     | A    |
| 持续正向整流峰值电流 | $I_{max}$       | 2       | A    |
| 峰值正向浪涌电流   | $I_{FSM}$       | 10      | A    |
| 结到管壳的热阻最大值 | $R_{\theta JA}$ | 200     | °C/W |
| 贮存温度       | $T_{stg}$       | -55~150 | °C   |

**电参数 (Per Diode)**

| 参数名称 | 符号    | 测试条件                        | 规范值 |    |     | 单位      |
|------|-------|-----------------------------|-----|----|-----|---------|
|      |       |                             | 最小  | 典型 | 最大  |         |
| 反向电压 | $V_R$ | $I_R=1mA$                   | 600 |    |     | V       |
| 反向电流 | $I_R$ | $V_R=600V, T_a=25^\circ C$  |     |    | 0.5 | $\mu A$ |
|      |       | $V_R=600V, T_a=125^\circ C$ |     |    | 2   |         |
| 正向压降 | $V_F$ | $I_F=0.25A$                 |     |    | 1.0 | V       |

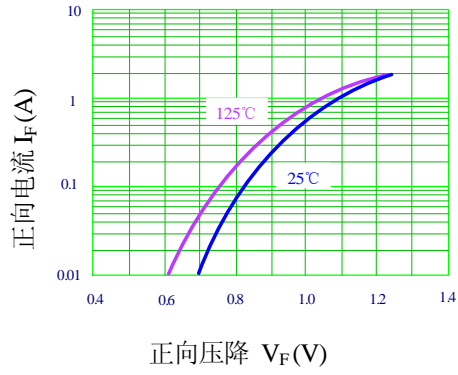
a: 脉冲测试  $t_p \leq 300 \mu s, \delta \leq 2\%$

**有害物质说明**

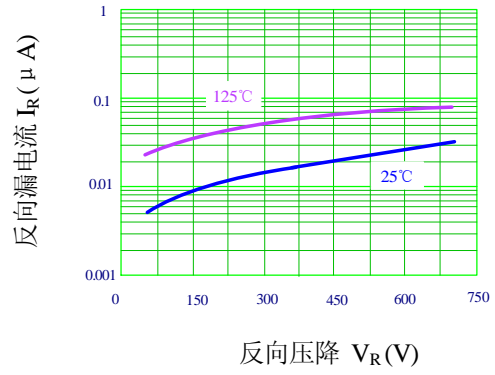
| 部件名称<br>(含量要求) | 有毒有害物质或元素  |              |               |               |                 |                   |                     |                    |                             |                             |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                | 铅<br>Pb  | 汞<br>Hg      | 镉<br>Cd       | 六价铬<br>Cr(VI) | 多溴<br>联苯<br>PBB | 多溴二<br>苯醚<br>PBDE | 六溴环<br>十二烷<br>HBCDD | 邻苯二<br>甲酸酯<br>DEHP | 邻苯二<br>甲<br>酸二丁<br>酯<br>DBP | 邻苯二<br>甲<br>酸丁苯<br>酯<br>BBP |
|                | $\leq 0.1\%$   | $\leq 0.1\%$ | $\leq 0.01\%$ | $\leq 0.1\%$  | $\leq 0.1\%$    | $\leq 0.1\%$      | $\leq 0.1\%$        | $\leq 0.1\%$       | $\leq 0.1\%$                | $\leq 0.1\%$                |
| 引线框            | ○  | ○            | ○             | ○             | ○               | ○                 | ○                   | ○                  | ○                           | ○                           |
| 塑封树脂           | ○  | ○            | ○             | ○             | ○               | ○                 | ○                   | ○                  | ○                           | ○                           |
| 管芯             | ○  | ○            | ○             | ○             | ○               | ○                 | ○                   | ○                  | ○                           | ○                           |
| 内引线            | ○  | ○            | ○             | ○             | ○               | ○                 | ○                   | ○                  | ○                           | ○                           |
| 焊料             | ×  | ○            | ○             | ○             | ○               | ○                 | ○                   | ○                  | ○                           | ○                           |
| 说明             | ○: 表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。<br>×: 表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。<br>目前产品的焊料中含有铅 (Pb) 成分, 但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。 |              |               |               |                 |                   |                     |                    |                             |                             |

**特性曲线**

$I_F$ - $V_F$ 关系曲线 (Per Diode)

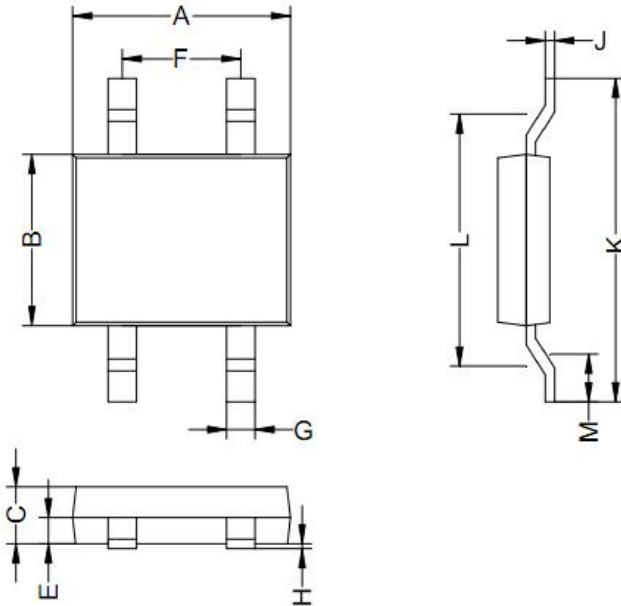


$I_R$ - $V_R$ 关系曲线 (Per Diode)



**外形图 SOP4**

(单位: mm)



| 项目 | 规范(mm)  |      |
|----|---------|------|
|    | MIN     | MAX  |
| A  | 4.5     | 4.7  |
| B  | 3.6     | 3.8  |
| C  | 1.2TYP. | 6.70 |
| E  | 0.45    | 0.65 |
| F  | 2.6     | 2.8  |
| G  | 0.6     | 0.8  |
| H  | 0.05    | 0.15 |
| J  | 0.2TYP. |      |
| K  | 6.6     | 7.0  |
| L  | 5.1     | 5.5  |
| M  | 0.9     | 1.1  |

**包装说明**

- 1) 产品的小包装, 采用 5000 只/盘的塑料袋包装;
- 2) 产品的中包装, 采用 2 盘/盒的中号纸盒包装;

**注意事项**

- 1) 凡华润华晶出厂的产品, 均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求; 对于客户有特殊要求的产品, 双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用; 在安装时, 要注意减少机械应力的产生, 防止由此引起的产品失效; 避免靠近发热元件; 焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) 本规格书由华润华晶公司制作, 并不断更新, 更新时不再专门通知。

**联络方式**
**无锡华润华晶微电子有限公司**

**公司地址** 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编: 214061

电话: 0510-8580 7228

网址: <http://www.crhj.com.cn>

传真: 0510-8580 0864

**市场营销部**

邮编: 214061

E-mail: [sales@hj.crmicro.com](mailto:sales@hj.crmicro.com)

电话: 0510-8180 5277 / 8180 5336

传真: 0510-8580 0360 / 8580 3016

**应用服务**

电话: 0510-8180 5243

传真: 0510-8180 5110